



# (10) **DE 600 05 939 T2** 2004.07.22

(12)

# Übersetzung der europäischen Patentschrift

(97) **EP 1 171 932 B1** 

(21) Deutsches Aktenzeichen: 600 05 939.1
(86) PCT-Aktenzeichen: PCT/US00/09283
(96) Europäisches Aktenzeichen: 00 921 850.4
(87) PCT-Veröffentlichungs-Nr.: WO 00/64010

(86) PCT-Anmeldetag: 06.04.2000

(87) Veröffentlichungstag

der PCT-Anmeldung: 26.10.2000

(97) Erstveröffentlichung durch das EPA: 16.01.2002

(97) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung beim EPA: **15.10.2003** (47) Veröffentlichungstag im Patentblatt: **22.07.2004** 

(30) Unionspriorität:

293120 16.04.1999 US

(73) Patentinhaber:

Sun Microsystems, Inc., Palo Alto, Calif., US

(74) Vertreter:

Patent- und Rechtsanwälte Bardehle, Pagenberg, Dost, Altenburg, Geissler, 81679 München

(51) Int CI.7: **H01R 12/18** 

(84) Benannte Vertragsstaaten:

DE, FR, GB, IE, IT, NL

(72) Erfinder:

HASSANZADEH, Ali, Fremont, US; ODISHO, Victor, San Jose, US

(54) Bezeichnung: SPEICHERMODULVERBINDUNG UND SPEICHERMODUL MIT OFFSET KERBEN FÜR VERBES-SERTES EINSTECKEN UND STABILITÄT

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99 (1) Europäisches Patentübereinkommen).

Die Übersetzung ist gemäß Artikel II § 3 Abs. 1 IntPatÜG 1991 vom Patentinhaber eingereicht worden. Sie wurde vom Deutschen Patent- und Markenamt inhaltlich nicht geprüft.

#### **Beschreibung**

## Hintergrund der Erfindung

#### 1. Gebiet der Erfindung

[0001] Diese Erfindung bezieht sich auf Speichermodule zur Erweiterung der Speicherkapazität in Computersystemen und auf Speichermodulanschlüsse bzw. Speichermodulverbinder.

## 2. Beschreibung des Stands der Technik

[0002] Sowohl einzelne Inline-Speichermodule (SIMMs) als auch duale Inline-Speichermodule (DIMMs) und entsprechende Speichermodulverbindungsbuchsen zum Erweitern des Speichers von Computersystemen sind allgemein bekannt. Im Allgemeinen umfassen Inline-Speichermodule eine Leiterplatte, auf der eine Mehrzahl von Speicherchips, wie beispielsweise DRAMs oberflächenbefestigt sind. Ein verbindender Teil entlang einer Kante der Leiterplatte ist angepasst für die Einbringung in einen Paarungs- (d. h. aufnehmenden) Raum eines Steckers. Eine Mehrzahl von Kontaktfeldern (auch Stifte bzw. Pins genannt) an dem verbindenden Bereich paart sich mit einer Mehrzahl von korrespondierenden Kontakten innerhalb des aufnehmenden Raums des Steckers, um den Transfer von elektrischen Signalen zwischen dem Speichermodul und dem Rest des Computersystems zu bewerkstelligen.

[0003] Auf einem SIMM umfasst der verbindende Bereich gewöhnlich eine Mehrzahl von Kontaktfeldern, entweder auf der Frontseite der Kante der Leiterplatte oder sowohl auf der Front- als auch auf der Rückseite der Leiterplatte. Bei Konfigurationen, die Kontaktfelder sowohl auf der Front- als auch auf der Rückseite eines SIMM beinhalten, werden typischerweise gegenüberliegende Kontaktfelder auf den zwei Seiten miteinander kurzgeschlossen und führen deshalb dasselbe elektrische Signal. In einem DIMM sind die Kontakte in dem verbindenden Teil sowohl auf der Front- als auch auf der Rückseite der Leiterplatte positioniert. Zumindest einige der gegenüberliegenden Kontaktfelder auf den zwei Seiten der Leiterplatte einer DIMM sind konfiguriert, um verschiedene elektrische Signale zu übertragen, wobei die Signaldichte erhöht wird, ohne dass kleinere Kontaktfelder oder eine größere Leiterplatte notwendig wären.

[0004] Die Fig. 1A und 1B veranschaulichen jeweils zwei Ausführungsformen von DIMM-Speichermodulen 100 und 150 gemäß dem Stand der Technik. Die Speichermodule 100 und 150 beinhalten, wie gezeigt, 84 Kontaktfelder, wie beispielsweise die Kontaktfelder 150A und 165A auf der Frontseite, um zusammen insgesamt 168 Kontaktfelder zu bilden. Es sollte festgehalten werden, dass die Anzahl der Kontaktfelder variieren kann, so dass Speichermodule mit bis zu 200 Kontaktfeldern am Markt erhältlich sind.

[0005] Die Speichermodule **100** und **150** sind konfiguriert, um mit geeigneten Speichermodul-Steckern verbunden zu werden, die speziell ausgestaltet sind, um mit dem Speichermodul zusammen zu passen und es zu sichern. Im allgemeinen weist ein Stecker ein Gehäuse auf, welches einen aufnehmenden Raum umfasst, der angepasst ist, um einen Teil der Leiterplatte des Speichermoduls aufzunehmen.

[0006] Betrachtet man Fig. 1A im Detail, so kann man feststellen, dass das Speichermodul 100 eine Leiterplatte 110 beinhaltet. Eine in gestrichelten Linien gezeigte Region 103 zur Platzierung von halbleiter-integrierten Schaltungen, wie beispielsweise DRAM-Speicherchips oder andere geeignete Speicher, belegen den Großteil des Raumes auf einer Fläche der Leiterplatte 110. Die Kontaktfelder 115 sind entlang einer Kante (d. h. im verbindenden Teil) der Leiterplatte 110 angeordnet, von einem kurzen Abstand von dem linken Ende bis zu ungefähr demselben Abstand vom rechten Ende. Die Mitte der Länge der Leiterplatte 110 ist mit einer Mittellinie 101 gekennzeichnet. Eine einzelne Nut 120 ist entlang der einen Kante im wesentlichen in der Mitte der Kante der Leiterplatte 110 positioniert. In anderen bekannten Ausführungsformen, kann die Nut 120 alternativ mit ungefähr der Hälfte der Breite der Nut nach jeder Seite der Zentralposition positioniert werden, wie durch die gestrichelten Linien kenntlich gemacht. Zusätzliche Details bzgl. der Nuten 120 können in Fig. 1C unten gefunden werden. Die Leiterplatte 110 beinhaltet auch Einkerbungen 105A und 105B, die jeweils an dem linken Ende und dem rechten Ende positioniert sind. Die Einkerbungen 105A und 105B sind so geformt, dass sie Modulauszieher aufnehmen, die als Teil des Steckers beinhaltet sein können, um das Speichermodul 100 festzuhalten, wenn die Modulauszieher in einer geschlossenen Position

[0007] Betrachtet man Fig. 1B im Detail, so stellt man fest, dass das Speichermodul 150 eine Leiterplatte 160 beinhaltet. Die Kontaktfelder 115 sind entlang einer Kante der Leiterplatte 160 angeordnet. Der Mittelpunkt der Länge der Leiterplatte 160 ist mit einer Mittelpunktslinie 151 gekennzeichnet. Eine Zentralnut 120A ist entlang der einen Kante positioniert, im wesentlichen in der Mitte der Kante der Leiterplatte 160. Das Speichermodul 150 umfasst eine linke Nut 120B, die links von der Mitte angeordnet ist. Ähnlich der Zentralnut 120A ist es auch von der Position der linken Nut 120B in anderen Ausführungsformen bekannt, dass sie ungefähr um die Hälfte der Breite der Nut 120B nach jeder Seite der dargestellten Position neu angeordnet wird. Die Leiterplatte 160 umfasst auch die Einkerbungen 105C und 105D, die jeweils an dem linken Ende und dem rechten Ende angeordnet sind.

[0008] **Fig.** 1C zeigt eine Großansicht der Nut **120**. Wie gezeigt ist die Nut **120** auf der Kante der Leiterplatte **110** oder **160** in einem Raum entlang der Reihe von Kontaktfeldern **115** positioniert. Die Höhe der Nut

**120** ist gerade ein wenig höher als die korrespondierende Größe der Kontaktfelder **115**. [0009] Es sollte festgehalten werden, dass die Nu-

ten 120 konfiguriert sind, um mit Passfedern in dem

aufnehmenden Raum in dem Gehäuse des korrespondierenden Verbinders zusammenzupassen. Eine zentrale Passfeder, die konfiguriert ist, um mit der Zentralnut 120 oder 120A des Verbinders zusammenzupassen, kann bezeichnet werden als die "Spannungs-Passfeder" (voltage key), während die linke Passfeder, die konfiguriert ist, um mit der linken Nut 120B zusammenzupassen, als die "Funktionalitäts-Passfeder" bezeichnet werden kann. Die Namen beziehen sich auf die unterschiedlichen Spannungen und/oder Funktionalitäten, die den drei Positionen für jede Passfeder (und daher Einkerbung) entsprechen, abhängig von dem Hersteller oder dem Standard. [0010] Ein Problem, welches mit den Speichermodulen 100 und 150 in Verbindung gebracht wird, ist die Schwierigkeit, die Speichermodule 100 oder 150 korrekt in dem entsprechenden Verbinder zu installieren. Selbst mit Installationsführungen als Teil des Verbinders, kann das Speichermodul 100 oder 150 verkehrt herum oder ungleichmäßig installiert werden. Während die Verbindung eines polarisierten Zwei-Nut-Speichermoduls wie beispielsweise Speichermodul 150, die Wahrscheinlichkeit, das Speichermodul verkehrt herum zu installieren vermindert. können die Nuten 120A und 120B nicht dazu beitragen, das Speichermodul gleichmäßig zu installieren. Es ist möglich, das Speichermodul 150 mit einer leichten Neigung zu installieren, was zu einer oder mehreren Fehlverbindungen oder sogar Kurzschlüssen führen kann. Ein verwandtes Problem ist die Stabilität des Speichermoduls 100 oder 150, wenn es einmal in den entsprechenden Verbinder eingesetzt wurde. Zusätzliche stabilisierende Merkmale können eine einfache und genaue Anbringung verhindern, was weiterhin zu ungleichmäßiger Einbringung und ungenauen Verbindungen führen kann. Deshalb ist es offensichtlich, dass ein verbessertes Speichermodul, Verbinder und System mit erleichterter Einbringung und verbesserter Stabilität gewünscht ist. Ein Speichermodul, das die Merkmale des Oberbegriffs von Anspruch 1 aufweist, wird in dem Dokument US-A-5,470,240 beschrieben.

### Zusammenfassung der Erfindung

[0011] Die oben dargelegten Probleme werden größtenteils gelöst durch ein verbessertes Speichermodul mit versetzten Nuten für eine verbesserte Anbringung und Stabilität und durch einen Speichermodulverbinder, der konfiguriert ist, um das Speichermodul aufzunehmen. In einer Ausführungsform umfasst der Verbinder ein erstes Ende, ein zweites Ende und eine zentrale Mittellinie zwischen dem ersten Ende und dem zweiten Ende. Das Gehäuse des Verbinders umfasst weiterhin einen aufnehmenden Raum zur Aufnahme eines verbindenden Teils einer

Leiterplatte eines Speichermoduls. Eine erste Passfeder und eine zweite Passfeder werden innerhalb des aufnehmenden Raums des Gehäuses angeordnet. Die erste Passfeder wird zwischen dem ersten Ende des Gehäuses und der Mitte angeordnet. Die zweite Passfeder ist zwischen dem zweiten Ende des Gehäuses und der Mitte angeordnet. Ein Abstand zwischen der ersten Passfeder und der zweiten Passfeder ist größer als 40% der Länge des Gehäuses des Verbinders. In einer Ausführungsform erstrecken sich eine oder mehrere der ersten Passfedern und der zweiten Passfedern von dem aufnehmenden Raum bis über eine obere Ebene hinaus, die durch eine Oberseite des aufnehmenden Raums des Gehäuses definiert wird. Der Abstand zwischen den Passfedern kann vorteilhafterweise für eine größere Stabilität des Speichermoduls sorgen, das mit dem Verbinder gekoppelt ist, ohne die leichte Einführbarkeit zu beeinträchtigen.

[0012] In einer anderen Ausführungsform wird ein Speichermodul betrachtet, welches eine Leiterplatte umfasst, die einen verbindenden Teil umfasst, der konfiguriert ist, um in einen Speichermodulverbinder eingesetzt zu werden. Der verbindende Teil der Leiterplatte umfasst ein erstes Ende, ein zweites Ende und eine zentrale Mittellinie zwischen dem ersten Ende und dem zweiten Ende. Eine erste Nut und eine zweite Nut werden in dem verbindenden Teil der Leiterplatte positioniert.

[0013] Die erste Nut wird zwischen dem ersten Ende der Leiterplatte und der Mitte positioniert. Die zweite Nut wird positioniert zwischen dem zweiten Ende der Leiterplatte und der Mitte. Der Abstand zwischen der ersten Nut und der zweiten Nut ist größer als 40% der Länge der Leiterplatte. In einer Ausführungsform ist die erste Nut weiter entfernt von dem ersten Ende der Leiterplatte als von der Mitte und die zweite Nut ist näher zu dem zweiten Ende der Leiterplatte als zu der Mitte hin angeordnet. Der Abstand zwischen den Nuten kann vorzugsweise eine größere Stabilität des Speichermoduls erlauben, während es an eine Verbinderbuchse gekoppelt ist, ohne die leichte Einführbarkeit zu beeinträchtigen Kurze Beschreibung der Zeichnungen Andere Ziele und Vorteile der Erfindung werden offensichtlich durch das Lesen der folgenden detaillierten Beschreibung und durch Bezugnahme auf die begleitenden Zeichnungen, in denen:

[0014] **Fig.** 1A und B Seitenansichten von Ausführungsformen von Speichermodulen des Stands der Technik sind;

[0015] **Fig.** 1C eine vergrößerte Ansicht einer Stand-der-Technik-Nut ist;

[0016] **Fig.** 2A eine Ausführungsform eines Speichermoduls ist, welches versetzte Nuten umfasst für eine verbesserte Einbringung in einen Verbinder, welcher versetzte Passfedern umfasst;

[0017] **Fig.** 2B eine Seitenansicht einer Ausführungsform des Speichermoduls und des Verbinders gemäß **Fig.** 2A ist;

[0018] **Fig.** 2C eine vergrößerte Ansicht einer in **Fig.** 2B gezeigten Nut ist;

[0019] **Fig.** 2D und 2E Draufsicht und Unteransicht eines Verbinders gemäß **Fig.** 2B sind; und

[0020] **Fig.** 3 ein dreidimensionales Schnittbild eines Computersystems ist, welches das Speichermodul gemäß **Fig.** 2A gekoppelt mit dem Verbinder gemäß **Fig.** 2A umfasst.

[0021] Während die Erfindung verschiedenen Modifikationen und alternativen Ausführungsformen zugänglich ist, werden spezielle Ausführungsformen davon mittels Beispiel in den Zeichnungen gezeigt und werden hier im Detail beschrieben. Es sollte jedoch berücksichtigt werden, dass die Zeichnungen und die detaillierte Beschreibung hierzu nicht beabsichtigen, die Erfindung auf die spezielle offenbarte Form einzuschränken, sondern im Gegenteil ist es beabsichtigt, alle Modifikationen, Äquivalente und Alternativen abzudecken, die vom Geist und vom Rahmen der vorliegenden Erfindung umfasst sind, wie sie durch die beigefügten Ansprüche definiert werden.

## Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0022] In Fig. 2A wird eine Ausführungsform eines Speichermodul 201, welches versetzte Nuten 220 umfasst, für ein verbessertes Einbringen in einen Verbinder 202, welcher versetzte Passfedern 270 umfasst, in einer dreidimensionalen Ansicht 200A gezeigt. Das Speichermodul 201 umfasst eine Leiterplatte 210. Die Leiterplatte 210 wird gezeigt als eine mehrlagige zusammengesetzte Leiterplatte, welche eine Region (siehe 202 in Fig. 2B) für einen oder mehrere Halbleiterspeicherchips wie beispielsweise DRAMs umfasst. Die Mitte der Länge der Leiterplatte 210 ist gekennzeichnet mit einer Mittellinie 201. Das Speichermodul 201 umfasst eine erste Nut 220A, die entlang einer Kante der Leiterplatte 210 positioniert ist, zwischen dem ersten Ende (links wie gezeigt) der Leiterplatte 210 und der Mitte der Leiterplatte 210. Eine zweite Nut 220B wird entlang derselben Kante der Leiterplatte 210 positioniert, zwischen einem zweiten Ende (rechts wie gezeigt) der Leiterplatte 210 und der Mitte der Leiterplatte 210. Der Abstand zwischen der ersten Nut und der zweiten Nut ist größer als 40% der Länge der Leiterplatte 210.

[0023] Eine Mehrzahl von Kontaktfeldern 215 kann auch enthalten sein entlang der Kante der Leiterplatte 210 des Speichermoduls 201. Wie gezeigt, teilen die ersten und die zweiten Nuten 220A und 220B die Kontaktfelder 215 in drei Gruppen. Die erste Gruppe ist zwischen der ersten Kante und der Leiterplatte 210 und der ersten Nut 220A angeordnet. Die zweite Gruppe ist zwischen der ersten Nut 220A und der zweiten Nut 220B angeordnet. Die dritte Gruppe ist zwischen der zweiten Nut 220B und der zweiten Kante der Leiterplatte 210 angeordnet. Ähnliche Gruppierungen der Kontakte der Verbinder 202 werden detaillierter diskutiert mit Bezug auf Fig. 2D.

[0024] Das Speichermodul 201 kann auch die Ein-

kerbungen 205A und 205B umfassen, die an den Enden der Leiterplatte 210 des Speichermoduls 201 angeordnet sind. Die Einkerbungen 205A und 205B sind jeweils konfiguriert, um einen korrespondierenden Teil eines Modulausziehers eines Verbinders aufzunehmen, wie beispielsweise die Modulauszieher 255 des Verbinders 202.

[0025] In einer Ausführungsform ist die erste Nut 220A weiter entfernt von dem ersten Ende der Leiterplatte 210 als von der Mitte, während die zweite Nut 220B näher zu dem zweiten Ende der Leiterplatte 210 liegt, als zu der Mitte. In einer anderen Ausführungsform ist die Mehrzahl von Kontaktfeldern 215 konfiguriert, um eine korrespondierende Mehrzahl von Kontakten 265 in einem aufnehmenden Raum 260 eines Verbinders zu berühren, wie beispielsweise Verbinder 202, wenn die Leiterplatte 210 innerhalb des aufnehmenden Raums 260 aufgenommen wird. [0026] Wie in Fig. 2A gezeigt, ist der Anschluss 202 konfiguriert, um ein Speichermodul aufzunehmen, wie beispielsweise Speichermodul 201. Der Anschluss 202 umfasst ein Gehäuse 250 mit einer bestimmten Länge. Die Mitte der Länge wird gezeigt mit der Mittellinie 201. Das Gehäuse 250 umfasst ein erstes Ende und ein zweites Ende auf eine Weise. dass die Leiterplatte 210 des Speichermoduls 201 parallel ist. Das Gehäuse 250 umfasst weiterhin einen aufnehmenden Raum 260, der angepasst ist, um einen Teil einer Leiterplatte aufzunehmen, wie beispielsweise die Leiterplatte 210 des Speichermoduls 201. Eine erste Passfeder 270A wird innerhalb des aufnehmenden Raums des Gehäuses 250 angeordnet und zwischen dem ersten Ende des Gehäuses 250 und der Mitte positioniert. Eine zweite Passfeder 270B wird ebenfalls innerhalb des aufnehmenden Raums des Gehäuses 250 zwischen dem zweiten Ende des Gehäuses 250 und der Mitte angeordnet. Der Abstand zwischen der ersten Passfeder und der zweiten Passfeder ist größer als 40% der Länge des Gehäuses 250.

[0027] Das Gehäuse 250 des Verbinders 202 umfasst vorzugsweise eine Mehrzahl von Kontakten 265, die innerhalb des aufnehmenden Raums 260 angeordnet sind. Die Kontakte 265 sind konfiguriert, um eine korrespondierende Mehrzahl von Kontaktfeldern 215 auf der Leiterplatte 210 zu berühren, wenn die Leiterplatte 210 teilweise innerhalb des aufnehmenden Raums 260 aufgenommen wird. Der Anschluss 202 umfasst ebenfalls vorzugsweise zwei Modulauszieher 255A und 255B, welche jeweils mit einem Ende des Gehäuses 250 verbunden sind. Jeder Modulauszieher 255 ist drehbar bedienbar, um sich zwischen einer geschlossenen Position (gezeigt in Fig. 3) und einer offenen Position (gezeigt in Fig. 2A und 2B) zu bewegen. In der geschlossenen Position ist jeder Modulauszieher 255 bedienbar, um "in eine korrespondierende Einkerbung einzurasten, wie beispielsweise in die Einkerbungen 205 des Speichermoduls 201". Wie gezeigt, kann sich eine Mehrzahl von Lötanschlüssen 280 von der Bodenseite des Verbinders **202** erstrecken. Die Lötanschlüsse **280** sind geeignet, um den Verbinder **202** elektrisch durch eine Montageoberfläche zu verbinden.

[0028] Das Speichermodul **201** ist in **Fig.** 2A gezeigt, kurz vor der Kopplung mit dem Anschluss **202**, wie durch die Pfeile zwischen den Nuten **220** und den Passfedern **270** angedeutet. Wenn die Kopplung vollendet ist, werden sich die Modulauszieher **255** mit den Einkerbungen **205** paaren, wenn das Speichemodul **201** und der Verbinder **202** mechanisch und elektrisch sicher "verrasten".

[0029] In einer Ausführungsform umfasst das Gehäuse 250 des Verbinders 202 eine Oberseite, die eine obere Ebene des aufnehmenden Raumes 260 definiert. In dieser Ausführungsform erstrecken sich eine oder mehrere der Passfedern 270A und 270B von dem aufnehmenden Raum 260 über die obere Ebene hinaus. Eine oder mehrere Passfedern 270 können sich mit variierenden Beträgen über die obere Ebene des aufnehmenden Raumes 260 hinaus erstrecken. In einer bevorzugten Ausführungsform erstrecken sich beide Passfedern 270A und 270B von dem aufnehmenden Raum 260 über die obere Ebene hinaus, mit einem Abstand von mindestens 0,050 inches (1,27 mm). In einer anderen Ausführungsform ist die erste Passfeder weiter entfernt von dem ersten Ende des Gehäuses 250 als von der Mitte. In dieser Ausführungsform ist die zweite Passfeder näher an dem zweiten Ende des Gehäuses 250 als an der Mit-

[0030] In verschiedenen Ausführungsformen kann die Anzahl von Kontakten 265 innerhalb des aufnehmenden Raumes 260 über zumindest 200 Kontakte variieren. In einer bevorzugen Ausführungsform umfasst die Mehrzahl von Kontakten 265 232 Kontakte. In einer bevorzugten Ausführungsform wird die Mehrzahl von Kontakten 265 innerhalb des aufnehmenden Raums 260 angeordnet, um vertikal entgegengesetzt zueinander angeordnet zu sein. Wenn der Teil der Leiterplatte 210 in den aufnehmenden Raum 260 eingebracht wird, wird die Leiterplatte 210 schwach gehalten zwischen den Kontakten 265. Wenn die Leiterplatte 210 nach unten in eine Implementierungsposition gedrückt wird, verformt eine Spitze der Leiterplatte 210 die Kontakte 265 elastisch, so dass die Kontaktfelder 215 der Leiterplatte 210 und die Kontakte 265 in Kontakt miteinander gebracht werden, wenn sie von der derart erzeugten elastischen Kraft gedrückt werden.

[0031] Eine Seitenansicht 200B des Speichermoduls 201 und des Verbinders 202 wird in Fig. 2B gezeigt. Der Teil 203 des Speichermoduls 201, der bedienbar ist, um Halbleiterchips aufzunehmen, ist schattiert dargestellt. Es werden die Nuten 220A und 220B sowie die in drei Gruppen unterteilten Kontaktfelder 215 gezeigt. Die Einkerbungen 205A und 205B werden ebenfalls hier gezeigt. Die Mitte des Speichermoduls 201 ist wiederum durch eine Mittelachse 201 gekennzeichnet. Der Verbinder 202 wird gezeigt mit den Modulausziehern 255A und 255B an den En-

den und den Passfedern 270A und 270B an der Oberseite, die sich von der oberen Ebene (d. h. der oberen Kante in der Seitenansicht) des aufnehmenden Raumes (nicht gezeigt) des Verbinders 202 erstrecken. Der Bereich um die Passfedern 270A und 270B herum ist weggeschnitten, um die Passfedern 270 zu zeigen. Die Bodenseite des Verbinders 202 zeigt zusätzliche Details in dieser Seitenansicht 200B. Neben einer Mehrzahl von Lötanschlüssen 280, wird auch eine Mehrzahl von Platzierungsstiften 285 auf dem Gehäuse 250 gegenüber dem aufnehmenden Raum (d. h. an der Unterseite) angeordnet. Jeder Platzierungsstift 285 ist konfiguriert, um sich mit einem korrespondierenden Loch in der Montageoberfläche zu paaren, wie beispielsweise einer Leiterplatte.

[0032] In verschiedenen Ausführungsformen kann die Position der ersten und zweiten Nuten 220A und 220B und der ersten und zweiten Passfeder 270A und 270B variieren. Es wurde angedacht, dass die erste Passfeder 270A entlang der Länge des Verbinders 202 angeordnet sein kann zwischen 15% und 35% der Länge, gemessen vom ersten Ende, während die zweite Passfeder 270B entlang dieser Länge zwischen 65% und 85% der Länge des Verbinders 202 angeordnet sein kann, ebenfalls gemessen vom ersten Ende. Es wurde entsprechend angedacht, dass die erste Nut 220A positioniert sein kann zwischen 15% und 35% der Länge des Speichermoduls 201, gemessen vom ersten Ende des Speichermoduls, während die zweite Nut 220B positioniert sein kann zwischen 65% bis 85% der Länge des Speichermoduls 201, ebenfalls gemessen vom ersten Ende. In einer Ausführungsform ist der Abstand zwischen der ersten Nut und der zweiten Nut nicht größer als 50% der Länge des Speichermoduls. In einer anderen Ausführungsform ist der Abstand zwischen der ersten Passfeder und der zweiten Passfeder größer als 50% der Länge des Verbinders.

[0033] In einer angedachten Ausführungsform ist die Passfeder mindestens 1,525 inches (38,74 mm) von dem ersten Ende entfernt und die zweite Passfeder ist mindestens 0,825 inches (20,96 mm) von dem zweiten Ende entfernt. In einer bevorzugten Ausführungsform ist die erste Passfeder 0,061 inches (1,55 mm) breit und 1,900 inches (48,26 mm) von dem ersten Ende entfernt. In dieser Ausführungsform weist die zweite Passfeder ebenfalls eine Breite von 0,061 inches (1,55 mm) auf und ist 5,50 inches (139,7 mm) von dem ersten Ende entfernt.

[0034] In verschiedenen Ausführungsformen kann die Anzahl und die Position der Platzierungsstifte variieren. Die dargestellte Ausführungsform umfasst vier Platzierungsstifte. Die zwei äußeren Platzierungsstifte **285A** und **285D** sind jeweils 0,075 inches (1,91 mm) von den linken und rechten Enden positioniert. Die zwei inneren Platzierungsstifte **285B** und **285C** sind 3,600 inches (91,44 mm) voneinander beabstandet, entsprechend den Positionen der ersten und zweiten Passfeder **270A** und **270B**. Es sollte

festgehalten werden, dass die Mehrzahl der Lötanschlüsse **280** neu angeordnet werden kann, so dass die Platzierungsstifte **285** wie gewünscht entlang der Unterseite des Verbinders **202** positioniert werden können. In einer bevorzugten Ausführungsform sind zwei Platzierungsstifte **285** zumindest 3,600 inches (91,44 mm) voneinander beabstandet.

[0035] Es sollte festgehalten werden, dass in verschiedenen Ausführungsformen die Dimension des Speichermoduls 201 variieren kann. Die Gesamtlänge des Speichermoduls 201 ist vorzugsweise 6,400 ± 0,005 inches (162,56 ± 0,127 mm). Die Gesamtspannweite der Mehrzahl von Kontaktfeldern 215 beträgt vorzugsweise 5,95 inches (151,13 mm), mit einem Raum von 0,150 inches (3,81 mm) der für jede Position jeder Nut 220 freigehalten wird. Jedes Kontaktfeld 215 ist vorzugsweise und typischerweise 0,050 inches (1,27 mm) beabstandet. Die Höhe der Speichermodule 201 beträgt vorzugsweise 2,000 inches (50,8 mm), wobei jede Einbuchtung 205 0,700 inches (17,78 mm) von der Kante positioniert ist, die die Kontaktfelder 215 umfasst. Die Tiefe der Speichermodule 201 weist ein bevorzugtes Maximum von 0,290 inches (7,37 mm) auf. Der Teil der Leiterplatte 210 des Speichermoduls 201, welcher sich mit dem Verbinder 202 paaren soll, beträgt vorzugsweise 0,175 inches (4,45 mm) als Minimum mit einer Breite von  $0.050 \pm 0.004$  inches  $(1.27 \pm 0.10 \text{ mm})$ .

[0036] Ebenso können die Dimensionen des Verbinders **202** bei jeder Ausführungsform variieren. In einer bevorzugten Ausführungsform beträgt die Gesamtlänge des Gehäuses **250** des Verbinders **202** 6,914 inches (175,62 mm), mit 6,550 inches (166,37 mm) zwischen den Mittelpunkten der zwei äußeren Platzierungsstifte **285**. Der Gesamtabstand, der durch die Lötanschlüsse **280** abgedeckt wird, beträgt 5,95 inches (151,13 mm), mit 1,525 inches (38,74 mm) von dem linken Ende zu der Mitte der ersten Passfeder **270A** und 0,825 inches (20,96 mm) von der Mitte des zweiten Passfeder **270B** und dem rechten Ende der Lötanschlüsse **280**.

[0037] **Fig.** 2C ist eine vergrößerte Ansicht einer Nut **220**. Die Nut **220** ist in einem Raum innerhalb der Mehrzahl von Kontaktfeldern **215** positioniert. Die Nut **220** ist "länger" als die angrenzenden Kontaktfelder **215**, mit einer bevorzugten Ausführungshöhe von 0,175 inches (4,45 mm) als Minimum bis zu einer Höhe von 0,100 inches (2,54 mm) für jedes Kontaktfeld **215**. Die bevorzugte typische Breite jedes Kontaktfeldes beträgt 0,036 inches  $\pm$  0,002 inches (0,91  $\pm$  0,05 mm). Die Breite der Nut **220** beträgt vorzugsweise 0,071  $\pm$  0,004 inches (1,80  $\pm$  0,10 mm), im Gegensatz zu den breiteren Nuten, die typisch für den Stand der Technik sind.

[0038] Die **Fig.** 2D und 2E sind Draufsicht und Unteransicht des Verbinders **202**. In **Fig.** 2D wird eine Draufsicht des Verbinders **202** dargestellt. Die Mitte des Verbinders **202** wird durch eine Mittellinie **201** gekennzeichnet. Der aufnehmende Raum **260** ist sichtbar und verläuft entlang der Mitte der Länge des Ver-

binders 202. Die erste Passfeder 270A und die zweite Passfeder 270B werden in ihren jeweiligen Räumen innerhalb der Mehrzahl von Kontakten 215 gezeigt. Es gibt zwei Modulauszieher 255A und 255B, die von oben an den Enden des Verbinders 202 gezeigt werden. Wie gezeigt, sind die Passfedern 270A und 270B integrale Komponenten einer Ausformung des Gehäuses 250 des Verbinders 202, obwohl eine Ausführungsform, bei der die Passfedern 270A und 270B keine integralen Komponenten sind, auch in Betracht kommt. Das Gehäuse 250 kann aus nicht leitendem Harz oder Plastik bestehen, wie es im Stand der Technik wohl bekannt ist.

[0039] In der dargestellten Ausführungsform wird die Mehrzahl der Kontakte 215 in drei Gruppen getrennt durch die Passfedern 270A und 270B. Die erste Gruppe 291 der Kontakte 215 ist angeordnet zwischen dem linken Ende des Verbinders 202 und der ersten Passfeder 270A. Die zweite Gruppe 292 der Kontakte 215 ist angeordnet zwischen der ersten Passfeder 270A und der zweiten Passfeder 270B. Die dritte Gruppe 293 der Kontakte 215 ist angeordnet zwischen der zweiten Passfeder 270B und dem rechten Ende des Verbinders 202. Wie gezeigt, ist die erste Passfeder weiter weg von dem linken Ende des Gehäuses 250 des Verbinders 202 als von der Mittellinie 201. Die zweite Passfeder ist näher an dem rechten Ende des Gehäuses des Verbinders 202 als an der Mittellinie 201 angeordnet.

[0040] In verschiedenen Ausführungsformen kann es eine unterschiedliche Anzahl von Kontakten 215 geben, und die Kontakte 215 können durch die Passfedern 270A und 270B in Gruppen mit unterschiedlichen Anzahlen von Kontakten in jeder Gruppe 291, 292 und 293 der Kontakte 215 getrennt sein. In einer Ausführungsform umfasst die Mehrzahl der Kontakte zumindest 200 Kontakte. In einer bevorzugten Ausführungsform umfasst die Mehrzahl von Kontakten exakt 232 Kontakte. In verschiedenen Ausführungsformen ist die Passfeder entlang der Länge des Gehäuses 250 des Verbinders 202 angeordnet zwischen 15% und 35% der Länge des Verbinders, gemessen von dem linken Ende und die zweite Passfeder ist angeordnet entlang der Länge des Gehäuses 250 des Verbinders zwischen 65% und 85% der Länge des Verbinders, ebenfalls gemessen von dem ersten Ende.

[0041] In einer Ausführungsform ist die Anzahl der Kontakte der zweiten Gruppe größer als die Anzahl der Kontakte in sowohl der ersten als auch der zweiten Gruppe. In einer angedachten Ausführungsform ist die Anzahl der Kontakte dieser zweiten Gruppe größer als die Anzahl der Kontakte der ersten Gruppe und der zweiten Gruppe zusammen. In einer bevorzugten Ausführungsform umfasst die erste Gruppe zumindest 60 Kontakte, die zweite Gruppe umfasst zumindest 140 Kontakte und die dritte Gruppe umfasst zumindest 32 Kontakte.

[0042] Es sollte festgehalten werden, dass wie gezeigt, die Mehrzahl von Kontakten 215 innerhalb des

aufnehmenden Raum 260 angeordnet ist, so dass sie vertikal einander gegenüberliegen. Ein Teil der Leiterplatte 210 wie beispielsweise in einem Speichermodul 201 enthalten, wird schwach gehalten zwischen den vertikal gegenüberliegenden Kontakten, in einem solchen Zustand, dass der Teil der Leiterplatte 210 in den aufnehmenden Raum 260 eingesetzt ist. und wenn die Leiterplatte 210 nach unten in eine Implementierungsposition gedrückt wird, verformt eine Spitze der Leiterplatte 210 die Kontakte 265 elastisch, so dass die Kontaktfelder 215 der Leiterplatte und die Kontakte 265 miteinander in Kontakt gebracht werden. Die Leiterplatte 210 wird in dieser Position in dem aufnehmenden Raum 260 von einer elastischen Kraft festgehalten, die von den verformten Kontakten 215 ausgeübt wird.

[0043] In Fig. 2E wird eine Unteransicht des Verbinders 202 dargestellt. Die Mittelachse 201 kennzeichnet die Mitte des Verbinders 202 auch in dieser Ansicht. Die relativen Positionen der Platzierungsstifte 285 und die Mehrzahl der Lötanschlüsse 280 werden dargestellt. Die äußeren Platzierungsstifte 285A und 285D werden in Richtung der Enden des Verbinders 202 positioniert. Die zwei inneren Platzierungsstifte 285B und 285C werden in der dargestellten Ausführungsform positioniert, um mit den Oberseitenräumen in den Kontakten 215 für die Passfedern 270 zu korrespondieren. Die Durchmesser der Platzierungsstifte 285 betragen vorzugsweise 0,080 ± 0,002 inches (2,03 ± 0,05 mm) außer für den am weitesten rechts gelegenen Platzierungsstift 285D, welcher einen Durchmesser von 0,093 ± 0,002 inches (2,36 ± 0,05 mm) aufweist.

[0044] Die Lötanschlüsse 280 werden in einer bevorzugten gestapelten Konfiguration gezeigt, welche vier Reihen von Lötanschlüssen 280 aufweist. Benachbarte Reihen von Lötanschlüssen 280 werden vorzugsweise getrennt durch 0,075 inches (1,19 mm), wobei 0,050 inches (1,27 mm) typisch sind für die Trennung zwischen den Lötanschlüssen 280, gemessen entlang der Länge des Verbinders 202. Jeder Lötanschluss 280 weist vorzugsweise einen Durchmesser von 0,031  $\pm$  0,002 inches (0,79  $\pm$  0,50 mm) auf. Wie gezeigt, korrespondieren "Stift 1" und "Stift 117" mit den am weitesten links gelegenen Lötanschlüssen 280, wobei "Stift 117" über "Stift 1" liegt. "Stift 116" und "Stift 232" korrespondieren mit den am weitesten rechts gelegenen Lötanschlüssen 280, wobei "Stift 232" über "Stift 116" liegt.

[0045] In Fig. 3 wird ein Teil des Computersystems 300 dargestellt, der eine Leiterplatte 310 umfasst, einen Anschluss 202, der an die Leiterplatte 310 gekoppelt ist, und ein Speichermodul 201, welches mit dem Verbinder 202 gepaart ist. Wie gezeigt, werden zwei Modulauszieher 255A und 255B mit entsprechenden Enden des Gehäuses 250 des Verbinders 202 gekoppelt. Beide Modulauszieher 255A und 255B sind in der geschlossenen Position und in korrespondierenden Einkerbungen des Speichermoduls positioniert. Der Randbereich des Speichermoduls

201 wird innerhalb eines aufnehmenden Raums des Verbinders 202 aufgenommen. Die erste Passfeder (vorher gezeigt) des Verbinders 202 wird innerhalb der ersten Nut (vorher gezeigt) des Speichermoduls 201 positioniert. Die zweite Passfeder des Verbinders 202 wird innerhalb der zweiten Nut des Speichermoduls 201 positioniert. Der Abstand zwischen der ersten und der zweiten Passfeder ist größer als 40% der Länge des Verbinders und der Abstand zwischen der ersten Nut und der zweiten Nut ist größer als 40% der Länge des Speichermoduls.

[0046] In verschiedenen Ausführungsformen des Computersystems 300 können kompatible Ausführungsformen des Verbinders 202 und/oder des Speichermoduls 201, wie oben beschrieben, in das Computersystem 250 eingebaut werden. In einer bevorzugten Ausführungsform weist das Computersystem weiterhin eine oder mehrere halbleiter-integierte Schaltungen auf, die an die Leiterplatte 210 des Speichermoduls 201 gekoppelt sind. Eine oder mehrere der halbleiter-integrierten Schaltungen umfassen eine Vielzahl von Speicherzellen, welche elektrisch gekoppelt werden mit verschiedenen Kontaktfeldern aus der Vielzahl der Kontaktfelder.

[0047] In verschiedenen Ausführungsformen kann das Gehäuse 250 des Verbinders 202 aus einem elektrisch nicht leitenden Material bestehen. Das elektrisch nicht leitende Material kann aus einem Harz oder einem Kunststoff oder einem anderen Material bestehen, wie gewünscht. In anderen Ausführungsformen kann das Speichermodul aus einem Verbundstoff bestehen, welcher eine Mehrzahl von Lagen umfasst. Die Mehrzahl von Lagen kann eine Mehrzahl von Lagen umfassen, die nicht leitend sind. Es sollte festgehalten werden, dass in einigen Ausführungsformen die Anzahl und die Platzierung von Merkmalen auf dem Speichermodul und/oder dem Verbinder eine korrespondierende Anzahl und/oder eine Platzierung von korrespondierenden Merkmalen auf dem Verbinder oder dem Speichermodul implizieren kann. Es sollte auch festgehalten werden, dass bei den angegebenen Messungen, bei denen ein Toleranzbereich nicht ausdrücklich erwähnt wurde, ein Toleranzbereich von 5 in der letzten Dezimalstelle impliziert ist. Verschiedene andere Variationen und Modifikationen werden für den Fachmann offensichtlich, wenn er die obige Offenbarung vollständig würdigt. Es wird beabsichtigt, dass die folgenden Ansprüche so interpretiert werden, dass sie alle solche Modifikationen und Variationen einschließen.

#### Patentansprüche

1. Speichermodul (201) aufweisend:

eine Leiterplatte (210) aufweisend ein erstes Ende, ein zweites Ende, eine Mitte in der Mitte zwischen dem ersten Ende und dem zweiten Ende und eine Kante die sich von dem ersten Ende zu dem zweiten Ende erstreckt; eine Mehrzahl Kontaktfelder (215) angeordnet entlang der Kante, wobei die Mehrzahl

Kontaktfelder (215) konfiguriert sind um anzuliegen an einer entsprechenden Mehrzahl Kontakten in einer Aufnahmeöffnung eines Anschlusses wenn die Leiterplatte (210) von der Aufnahmeöffnung empfangen wird;

eine erste Nut (220A) positioniert an der Kante zwischen dem ersten Ende von der Leiterplatte (210) und der Mitte; und

eine zweite Nut (220B) positioniert an der Kante zwischen dem zweiten Ende der Leiterplatte (210) und der Mitte:

wobei ein Abstand zwischen der ersten Nut (220A) und der zweiten Nut (220B) größer ist als 40% der Länge der Kante:

wobei die erste Nut (220A) und die zweite Nut (220B) die Mehrzahl Kontaktfelder (215) in drei Kontaktfeldergruppen aufteilt,

wobei die drei Kontaktfeldergruppen beinhalten eine erste Gruppe positioniert zwischen dem ersten Ende und der ersten Nut (220A), eine zweite Gruppe positioniert zwischen der ersten Nut (220A) und der zweiten Nut (220B) und eine dritte Gruppe positioniert zwischen der zweiten Nut (220B) und dem zweiten Ende:

#### dadurch gekennzeichnet, dass

die zweite Gruppe eine durchgehende Serie von gleich beabstandeten Kontaktfeldern (215) zwischen 40% und 70% der Länge der Kante aufweist.

- 2. Speichermodul (201) nach Anspruch 1, wobei die erste Nut (220A) weiter von dem ersten Ende der Leiterplatte (210) entfernt ist als von der Mitte; und wobei die zweite Nut (220B) näher zu dem zweiten Ende der Leiterplatte (210) ist als zu der Mitte.
- 3. Speichermodul (201) nach Anspruch 2, wobei die erste Nut (220A) mindestens 1.450 Inch von dem ersten Ende entfernt ist, und wobei die zweite Nut (220B) mindestens 0.750 Inch von dem zweiten Ende entfernt ist.
- 4. Speichermodul (201) nach Anspruch 2, wobei die erste Nut (220A) und die zweite Nut (220B) mindestens 1.140 Inch tief sind.
- 5. Speichermodul (201) nach Anspruch 1, wobei die Mehrzahl Kontaktfelder (215) 232 Kontaktfelder (215) beinhaltet.
- 6. Speichermodul (201) nach Anspruch 1, wobei die Mehrzahl Kontaktfelder (215) entlang der Kante auf einer Vorderseite und einer Rückseite verteilt sind, um vertikal gegenüber zueinander zu sein, wobei die Kante der Leiterplatte (210) schwach zwischen den Kontakten in der Aufnahmeöffnung in einem Zustand gehalten wird wo die Kante der Leiterplatte (210) in die Aufnahmeöffnung eingeführt ist, und wobei wenn die Leiterplatte (210) in eine Implementierungsposition heruntergedrückt wird, die Kante von der Leiterplatte (210) die Kontakte elastisch

deformiert, so dass die Kontaktfelder (215) der Leiterplatte (210) und die Kontakte in Kontakt miteinander gebracht werden wie durch die so erzielte elastische Kraft zusammengepresst.

- 7. Speichermodul (201) nach Anspruch 1, wobei die Anzahl der Kontaktfelder (215) in der zweiten Gruppe größer ist als die Anzahl der Kontaktfelder (215) in entweder der ersten Gruppe oder der dritten Gruppe.
- 8. Speichermodul (201) nach Anspruch 7, wobei die erste Gruppe mindestens 60 Kontaktfelder (215) beinhaltet, wobei die zweite Gruppe mindestens 140 Kontaktfelder (215) beinhaltet, und wobei die dritte Gruppe mindestens 32 Kontaktfelder (215) beinhaltet.
- 9. Speichermodul (201) nach Anspruch 7, wobei die Anzahl der Kontaktfelder (215) in der zweiten Gruppe größer ist als die Anzahl der Kontaktfelder (215) in der ersten Gruppe und der dritten Gruppe zusammen.
- 10. Speichermodul (201) nach Anspruch 1, wobei die erste Nut (220A) zwischen 15% und 35% der Länge der Kante angeordnet ist, wenn diese von dem ersten Ende der Leiterplatte (210) ausgemessen wird; und wobei die zweite Nut (220B) entlang der Länge der Kante zwischen 65% und 85% der Länge angeordnet ist, wenn diese von dem ersten Ende der Leiterplatte (210) gemessen wird.
- 11. Speichermodul (**201**) nach Anspruch 1, weiter aufweisend: eine oder mehrere Einbuchtungen, angeordnet an dem ersten Ende oder dem zweiten Ende, wobei die eine oder mehrere Einbuchtungen konfiguriert sind um Modulextraktoren in einer geschlossenen Position aufzunehmen.
- 12. Speichermodul (201) nach Anspruch 1, wobei ein Abstand zwischen der ersten Nut (220A) und der zweiten Nut (220B) größer ist als 50% von der Länge der Leiterplatte 210.
- 13. Speichermodul (201) nach Anspruch 12, wobei die Länge mindestens 5.950 Inch ist, und wobei der Abstand zwischen der ersten Nut (220A) und der zweiten Nut (220B) größer als 3.000 Inch ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen

# Anhängende Zeichnungen









